【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】令和6年10月2日(2024.10.2)

【国際公開番号】WO2023/140314
【出願番号】特願2023-575289(P2023-575289)
【国際特許分類】
C22C 9/06(2006.01)
C22C 9/10(2006.01)
C22C 9/02(2006.01)
C22F 1/00(2006.01)
C22F 1/08(2006.01)
【FI】
C22C 9/06
C22C 9/10
C22C 9/02
C22F 1/00 602
C22F 1/00 604
C22F 1/00 606
C22F 1/00 623
C22F 1/00 630A
C22F 1/00 630K
C22F 1/00 661A
C22F 1/00 682
C22F 1/00 683
C22F 1/00 685A
C22F 1/00 685Z
C22F 1/00 686A
C22F 1/00 691B
C22F 1/00 691C
C22F 1/00 692A
C22F 1/00 694A
C22F 1/00 694B
C22F 1/08 B
C22F 1/08 P
C22F 1/08 N
C22F 1/08 J

【手続補正書】
【提出日】令和6年4月9日(2024.4.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＮｉおよびＣｏの少なくとも一方の成分を合計で１．０質量％以上５．０質量％以下ならびにＳｉを０．１０質量％以上１．５０質量％以下含有し、残部がＣｕおよび不可避不純物からなる合金組成を有し、

圧延方向に対して平行であり、かつ板厚方向に沿った断面についてのＳＥＭ－ＥＢＳＤ法の結晶方位解析データから得られる、結晶方位の強度分布が示された逆極点図において、

前記圧延方向と平行になる＜００１＞方位を有する結晶粒の集積度が、８．０以上であり、かつ

前記圧延方向に対して垂直な板幅方向に、シュミット因子が０．４９以上となる方位を有する結晶粒の集積度が３．０以上である、銅合金板材。

【請求項２】

結晶粒の平均結晶粒径が３０μｍ以下の範囲であり、かつ、前記平均結晶粒径の標準偏差が１５μｍ以下である、請求項１に記載の銅合金板材。

【請求項３】

前記圧延方向および前記板幅方向のヤング率が、いずれも１２０ＧＰａ以下であり、かつ、

前記圧延方向の引張強さが６００ＭＰａ以上であり、前記板幅方向の引張強さが、前記圧延方向の引張強さよりも５０ＭＰａ以上低い、請求項１に記載の銅合金板材。

【請求項４】

前記合金組成は、さらに、Ｓｎ、Ｍｇ、Ｍｎ、Ｃｒ、Ｚｒ、Ｔｉ、ＦｅおよびＺｎからなる群から選択される少なくとも１種の成分を、合計で０．０１質量％以上１．２０質量％以下含有する、請求項１から３までのいずれか１項に記載の銅合金板材。